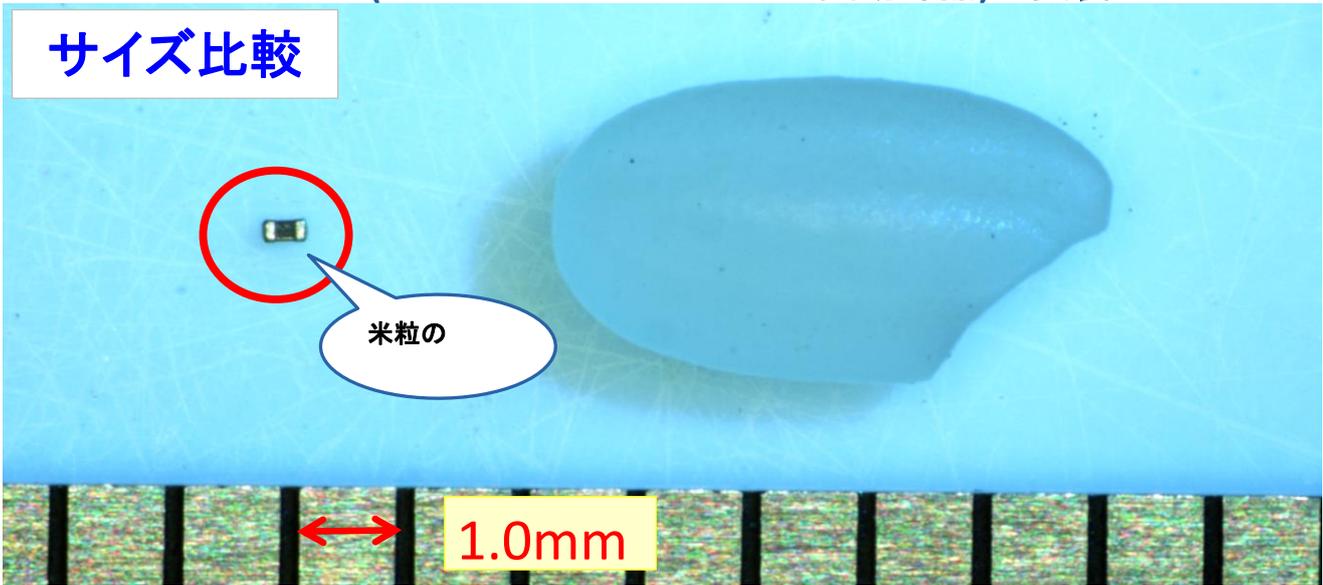
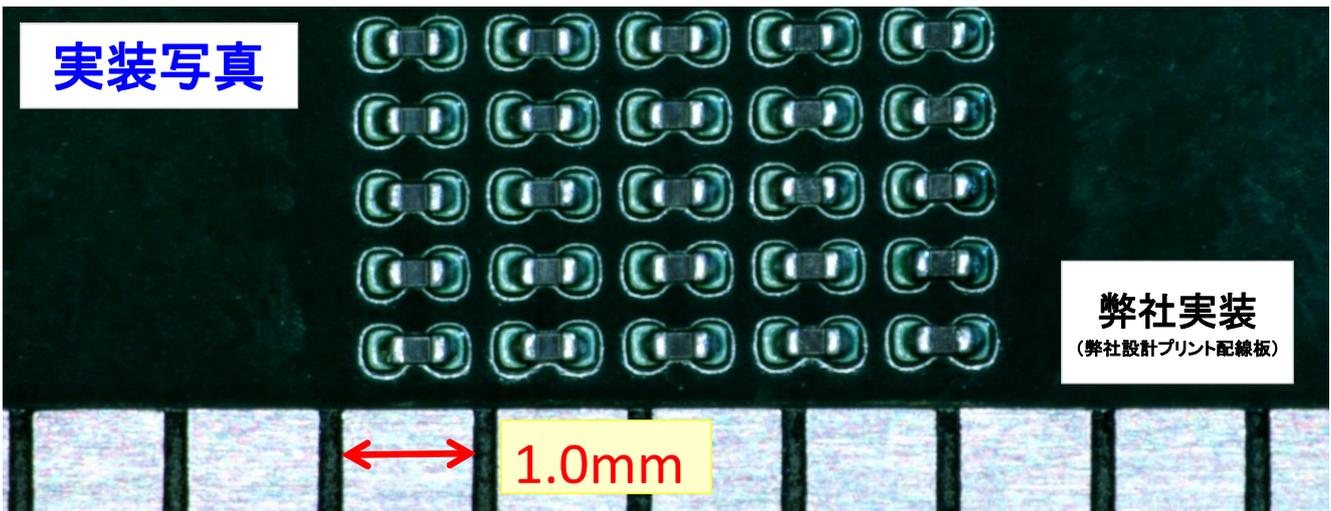


0402型 SMD (L0.4mm × W0.2mmサイズ受動部品)の実装

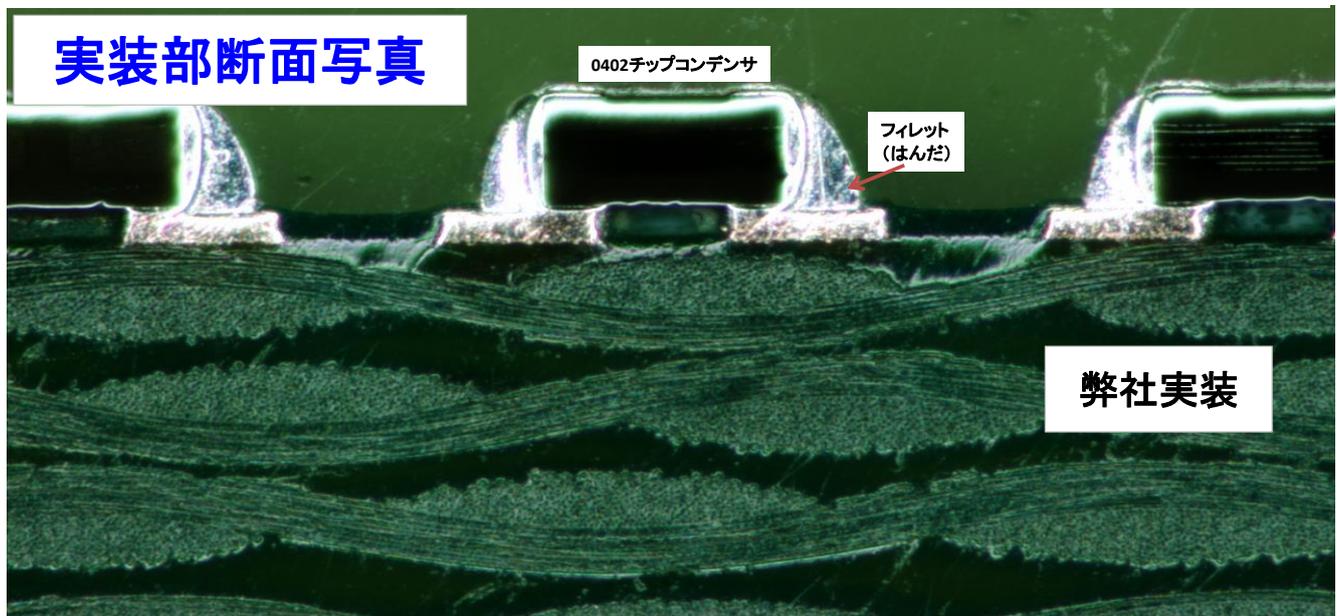
サイズ比較



実装写真



実装部断面写真



## ■PoP (Package on Package) の実装

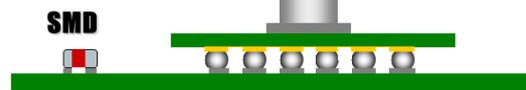
### ・On-board stack方式

基板にはんだを印刷後、親亀BGA ICを実装。  
子亀BGA ICにはんだ(フラックス)を転写し、親亀上を実装。

はんだ印刷

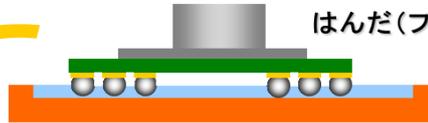


Bottom 部品実装

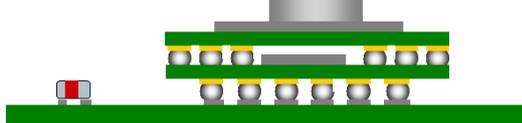


SMDとBottom 部品を同時に実装

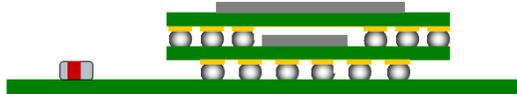
はんだ(フラックス)転写



Top 部品実装



リフロー



弊社蘇州工場にて量産中

